(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-240302 (P2002-240302A)

(43)公開日 平成14年8月28日(2002.8.28)

(51) Int.Cl.7 B41J

識別記号

FΙ

テーマコート*(参考)

2/045

2/16 2/055 B41J 3/04 103H 2C057

103A

審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 8 頁)

(21)出願番号

特願2001-39713(P2001-39713)

(22)出願日

平成13年2月16日(2001.2.16)

(71)出顧人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72)発明者 谷川 徹

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

一株式会社内

(72)発明者 牛之▲浜▼ 五輪男

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

一株式会社内

(74)代理人 100102185

弁理士 多田 繁範

Fターム(参考) 20057 AF93 AG12 AG54 AG83 AK07

APO2 AP31 AP37 AP52 AP54

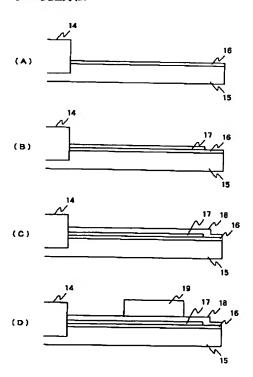
AP57 AP58 BA04 BA15

(54) 【発明の名称】 プリンタヘッドの製造方法及び静電アクチュエータの製造方法

(57)【要約】

【課題】 本発明は、プリンタヘッドの製造方法及び静 電アクチュエータの製造方法に関し、例えばインクジェ ット方式によるプリンタに適用して、簡易かつ確実に作 成することができ、また駆動回路等を容易に集積化する ことができるプリンタヘッドの製造方法と、このような プリンタヘッドに適用可能な静電アクチュエータの作成 方法を提案する。

【解決手段】 本発明は、固定電極17の上に犠牲層1 9を作成して可動電極を作成した後、この犠牲層19を 除去して固定電極17及び可動電極間に空隙を作成す る。



【特許請求の範囲】

【請求項1】固定電極と可動電極との間に発生する静電力により前記可動電極を可動させてインク液室の体積を可変し、所定のノズルよりインク液滴を飛び出させるプリンタヘッドの製造方法において、

1

所定の基板上に、前記固定電極を作成する固定電極の作成工程と、

前記固定電極の上に、犠牲層を作成する犠牲層の作成工 程と、

前記犠牲層の上に、前記可動電極を作成する可動電極の 10 作成工程と、

前記犠牲層を除去して前記固定電極及び前記可動電極間 に空隙を作成する犠牲層の除去工程とを有することを特 徴とするプリンタヘッドの製造方法。

【請求項2】少なくとも前記インク液室の空間、前記インク液室にインクを導くインク流路の空間の形状による型を、前記可動電極の上層側に作成する型の作成工程と、

前記型を含んで覆うように、前記インク液室及びインク 流路の壁材、前記ノズルの壁材を前記基板に付着させる 工程と、

前記型を除去する型除去工程とを有することを特徴とする請求項1に記載のプリンタヘッドの製造方法。

【請求項3】前記基板が、シリコン基板であることを特徴とする請求項1に記載のプリンタヘッドの製造方法。

【請求項4】前記基板に、前記固定電極及び前記可動電極間に電圧を印加する駆動回路が事前に作成されてなることを特徴とする請求項3に記載のプリンタヘッドの製造方法。

【請求項5】前記基板が、ガラス基板であることを特徴とする請求項1に記載のプリンタヘッドの製造方法。

【請求項6】前記基板に、前記固定電極及び前記可動電極間に電圧を印加するTFTトランジスタによる駆動回路が事前に作成されてなることを特徴とする請求項5に記載のプリンタヘッドの製造方法。

【請求項7】固定電極と可動電極との間に発生する静電力により前記可動電極を可動させる静電アクチュエータの製造方法において、

所定の基板上に、前記固定電極を作成する固定電極の作成工程と、

前記固定電極の上に、犠牲層を作成する犠牲層の作成工 程と、

前記犠牲層の上に、前記可動電極を作成する可動電極の 作成工程と、

前記犠牲層を除去して前記固定電極及び前記可動電極間 に空隙を作成する犠牲層の除去工程とを有することを特 徴とする静電アクチュエータの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、プリンタヘッドの 50

製造方法及び静電アクチュエータの製造方法に関し、例えばインクジェット方式によるプリンタに適用することができる。本発明は、固定電極の上に犠牲層を作成して可動電極を作成した後、この犠牲層を除去して固定電極及び可動電極間に空隙を作成することにより、簡易かつ確実に作成することができ、また駆動回路等を容易に集積化することができるプリンタヘッドの製造方法と、このようなプリンタヘッドに適用可能な静電アクチュエータの作成方法を提案する。

[0002]

【従来の技術】従来、インクジェット方式によるプリンタにおいては、発熱素子、ピエゾ素子の駆動により、インク液滴を飛び出させて用紙に付着させることにより、画像等を印刷するようになされている。これに対して例えば特開平10-315466号公報等においては、このような駆動を静電アクチュエータにより実行する方法が提案されるようになされている。

【0003】すなわち図7は、この静電アクチュエータによるプリンタヘッドを示す断面図である。このプリンタヘッド1は、所定の基板2の表面に、所定ピッチによる凹部が形成され、この凹部の底面に電極3が配置される。プリンタヘッド1は、この基板2上に、インク液室4の底板6、隔壁を構成する部材5が配置される。ここでこの部材5は、導電性の材料により形成され、基板2に配置した電極3とインク液室の底板6とが基板2の凹部による空隙を間に挟んで対向するように、また各電極3と絶縁されるように配置される。また部材5は、底板6が振動板として機能するように、所定の厚さにより形成され、部材5の上に、ノズル7が形成されてなる部材8が配置される。

【0004】この構成によりこのプリンタヘッド1では、部材5と各電極3との間に電圧を印加すると、底板6が電極3側に引き寄せられてたわみ、またこの電圧の印加を中止すると、このたわみが元に戻る。これによりプリンタヘッド1は、電極3に電圧を印加して発生する部材5との間の静電力によりインク液室4の体積を増減し、この体積が減じる際の圧力によりノズル7からインクを飛び出させるようになされている。

[0005]

40

【発明が解決しようとする課題】ところで発熱素子を使用したインクジェット方式のプリンタにおいては、発熱素子の駆動に多くの電力を要し、その分、全体として消費電力が大きい欠点がある。これに対してピエゾ素子を使用したインクジェット方式のプリンタにおいては、ピエゾ素子の集積化が困難で、これにより製造工程が複雑な欠点がある。このためこれら発熱素子、ピエゾ素子を使用したインクジェット方式のプリンタにおいては、これらの欠点を解消するために、また各種の性能向上のため等に、種々の手法が多数提案されている。

【0006】これに対して静電アクチュエータによるプ

4

リンタヘッドにおいては、発熱素子、ピエゾ素子を使用する場合に比して改良の余地が残っていると考えられ、このような発熱素子、ピエゾ素子を使用する場合の欠点についても、充分に対応することができると考えられる。

3

【0007】しかしながら従来の静電アクチュエータによりプリンタヘッドにおいては、上述したように基板2を加工した後、インク液室4の底板6、隔壁を構成する部材5、ノズル7が形成されてなる部材8を順次配置することにより、工程が複雑な問題がある。またこのように組み立てることにより、これら部材5、8の位置決め精度が劣る問題もあり、さらにはこれら基板2、部材5、8間でインクの液漏れが発生する恐れもある。またこのように部材5を基板2上に配置することにより、基板2及び部材5においては、接合部を平坦化することが必要であり、これにより基板2側に静電アクチュエータの駆動回路を集積化することも困難な問題がある。

【0008】本発明は以上の点を考慮してなされたもので、簡易かつ確実に作成することができ、また駆動回路等を容易に集積化することができるプリンタヘッドの製造方法、静電アクチュエータの作成方法を提案しようとするものである。

[0009]

【課題を解決するための手段】かかる課題を解決するため請求項1の発明においては、プリンタヘッドの製造方法に適用して、所定の基板上に、固定電極を作成する固定電極の作成工程と、この固定電極の上に、犠牲層を作成する犠牲層の作成工程と、この犠牲層の上に、可動電極を作成する作成工程と、この犠牲層を除去して固定電極及び可動電極間に空隙を作成する犠牲層の除去工程とを有するようにする。

【0010】また請求項7の発明においては、静電アクチュエータの製造方法に適用して、所定の基板上に、固定電極を作成する固定電極の作成工程と、この固定電極の上に、犠牲層を作成する犠牲層の作成工程と、この犠牲層を除去して固定電極及び可動電極間に空隙を作成する犠牲層の除去工程とを有するようにする。

【0011】請求項1の構成によれば、固定電極、犠牲層、可動電極を順次作成した後、犠牲層の除去工程によ 40って、犠牲層を除去して固定電極及び可動電極間に空隙を作成することにより、半導体製造プロセスによってこれらの処理を実行することができる。これにより簡易に作成することができ、また高い精度による位置決めすることができ、さらには駆動回路等の集積回路も基板に事前に作成することができる。これにより簡易かつ確実に作成することができる。また駆動回路等を容易に集積化することができる。

【0012】これにより請求項7の構成によれば、この 種のプリンタヘッドに適用することができる静電アクチ 50 ュエータの製造方法を提供することができる。

[0013]

【発明の実施の形態】以下、適宜図面を参照しながら本 発明の実施の形態を詳述する。

【0014】(1)第1の実施の形態

(1-1) 第1の実施の形態の構成

図2は、本発明の第1の実施の形態に係るプリンタへッドを示す断面図であり、連続して配置されたノズルの1つについて、このノズル12の中心を通る線により切り取って示すものである。また図3は、図2をA-A線により切り取って示す断面図である。

【0015】このプリンタヘッド11は、ラインプリンタに使用されるラインヘッドであり、印刷対象の用紙幅でノズル12が連続するように細長い形状により全体が形成される。このプリンタヘッド11は、静電力により駆動するアクチュエータである静電アクチュエータによりインク液室13内の圧力を可変し、ノズル12よりインク液滴を飛び出させると共に、図示しないインク流路よりインク液室13にインクを引き込む。このプリンタヘッド11は、基板15上に、半導体製造工程により順次構成部材を配置して作成される。

【0016】すなわち図1、図4~図6は、図2との対比により、このプリンタヘッド11の製造工程の説明に供する断面図である。このプリンタヘッド11は、事前の工程において、シリコン基板15に駆動回路14が作成され、CVD、熱処理等により絶縁膜16が作成される。ここでこの絶縁膜16は、例えばシリコン酸化膜、シリコン窒化膜等により構成される(図1(Λ))。

【0017】プリンタヘッド11は、このようにして絶縁膜16が作成されると、続いて固定電極の作成工程により静電アクチュエータを構成する固定電極17が作成される(図1(B))。すなわちプリンタヘッド11は、スパッタリング、蒸着等の処理により、所定形状によりで導電性膜が作成され、これにより固定電極17が作成される。なおここでこの導電性膜は、例えばアルミニューム、金、プラチナ等の金属膜により作成される。このようにして作成される固定電極17は、この工程で同時に作成される配線パターンにより駆動回路14の対応する部位に接続される。

【0018】プリンタヘッド11は、続いて絶縁膜18 が所定膜厚により成膜される(図1(C))。なおここ でこの絶縁膜18は、例えばシリコン酸化膜、シリコン 窒化膜6等により作成される。

【0019】プリンタヘッド11は、続いて犠牲層作成工程により犠牲層19が作成される(図1(D))。ここで犠牲層19は、いわゆるダミーの層であり、固定電極17と対向する電極である可動電極が作成された後に取り除かれることにより、固定電極17と可動電極との間に、この犠牲層19の膜厚による空隙を形成するために使用される部材である。犠牲層19は、例えばポリシ

リコン、金属材料、絶縁材料等を所定膜厚により成膜した後、例えばフォトリソグラフィーの処理により、余分な部分を除去して作成される。犠牲層19は、このように可動電極を作成した後に、除去することにより、この除去の際に、他の構成部材に何ら影響を与えないことが求められる。すなわちエッチングの条件により、他の構成部材との間で充分な選択比を確保できることが必要であり、このように選択比を実用上充分に確保することができれば、エッチングにより除去可能な種々の材料を広く適用することができる。

【0020】このようにして犠牲層19が作成される と、プリンタヘッド11は、シリコン酸化膜、シリコン 窒化膜等による絶縁膜20が成膜された後(図4

(E))、可動電極の作成工程により可動電極21が作成される(図4(F))。ここで可動電極21においても、固定電極17と同様に、スパッタリング、蒸着等の処理により所定形状により例えばアルミニューム、金、プラチナ等の金属膜による導電性膜が作成されて形成される。またこのようにして作成される可動電極21は、この工程で同時に作成される配線パターンにより駆動回路14の対応する部位に接続される。

【0021】続いてプリンタヘッド11は、振動板の作成工程により、可動電極21の上に、振動板22が作成される。ここで振動板22は、靭性、ヤング率が高く、硬くて脆くない材料が適用される。具体的に、シリコン酸化膜、シリコン窒化膜、シリコン、金属膜、アルミナ、ジルコニアなどのセラミックス材料等を使用して、可動電極21上に成膜して作成される。なおこの振動板22は、金属材料により作成する場合には、可動電極21と兼用することができる(図4(G))。

【0022】プリンタヘッド11は、続く犠牲層の除去工程により、犠牲層19が除去され、固定電極17及び可動電極21間に、この犠牲層19の厚みによる空隙23が作成される(図4(H))。ここでこの除去工程においては、犠牲層19の構成材料に応じて、ドライエッチング、ウェットエッチング等の各種エッチング処理等を適用することができる。

【0023】これらの処理によりプリンタヘッド11 は、半導体基板15の上に、所定の空隙23を間に挟ん で、固定電極17及び可動電極21が対向してなる静電 40 アクチュエータが作成される。

【0024】続いてプリンタヘッド11は、必要に応じて振動板に窒化シリコン等による保護層が作成された後、インク流路及びインク液室のパターン形状により犠牲層31が作成される(図5(I))。ここでこの犠牲層31は、インク液室、インク流路を構成する壁材等を配置した後、取り除くことにより、これらインク液室、インク流路の空間を作成する部材である。

【0025】ここで犠牲層31は、インク流路及びイン ク液室の高さより薄い膜厚であって、半導体製造工程に 50

より充分に均一に作成できる膜厚により作成される。また犠牲層31は、所定の反応工程により体積が増大し、かつこの体積が増大した後の状態で膜厚がインク流路及びインク液室の高さとなる材料により形成される。この実施の形態では、この反応工程が加熱の工程であり、この加熱の工程により発泡して体積が増大する材料(以下、発泡性レジストと呼ぶ)を使用して犠牲層31を作成した。すなわちこの反応工程によりガスを発生する気泡用の材料と、気泡間の膜を形成する所定の基材との混10 合物を犠牲層31に適用した。

6

【0026】具体的に、この気泡用の材料には、アゾビスイソブチロニトル(商品名:ビニホールΛZ、分解温度:114度 永和化成工業(株)製)を適用し、また基材には、ポジ型のレジスト(PFR-9500G、JSR製)を適用した。この実施の形態では、この基材49部に、気泡用の材料1部を添加し、充分に攪拌して完全に溶解させ、上述した条件を満足するように発泡性レジストを作製した。

【0027】プリンタヘッド11は、この発泡性レジストがスピンコートされた後、80度によりキュアされ、露光、現像の処理により犠牲層31が作成される。

【0028】プリンタヘッド11は、続いて感光性エポキシがスピンコートにより供給された後、所定の条件でキュアされ、これにより感光性エポキシがゲル化してなる被覆層32が犠牲層31側に全体を覆うように所定膜厚により作成される(図5(J))。ここでこの被覆層32は、インク流路、インク液室、ノズルを形成する材料層であり、この実施の形態では、キュア温度が犠牲層31の発泡温度より低く、かつ硬化温度が発泡温度より高い材料が選定されるようになされている。

【0029】プリンタヘッド11は、続く露光処理により、ノズル12の形状が露光される(図5(K))。

【0030】プリンタヘッド11は、続く反応工程において、全体が130度の温度により10分間加熱され、これによりこの反応工程における温度上昇により始めに犠牲層31を構成する材料が発泡し、犠牲層31の膜厚がインク液室13の厚さに増大する(図6(L))。またこのように犠牲層31の膜厚の増大に続いて、被覆層32の硬化が完了する。これによりプリンタヘッド11は、多数の気泡を有する犠牲層31によりインク流路、インク液室の形状が形成されて、全体が硬化した被覆層32により覆われた状態となる。

【0031】続いてプリンタヘッド11は、ノズル12に詰まったエポキシ材が除去された後、半導体基板15の裏面側がレジストによりパターンニングされ、化学的異方性エッチングにより、半導体基板15の裏面側にインク流路へのインク供給孔が形成される(図示せず)。続いてプリンタヘッド11は、メタノールを溶媒として使用した洗浄工程において、インク供給孔、ノズル12を介して犠牲層31を除去し、インク液室13、インク

流路が形成される(図6(M))。

【0032】プリンタヘッド11は、続いてダイシング ソーにより、半導体基板15が各チップに分割され、こ のチップが所定の部材に保持されてインク供給孔がイン クカートリッジに接続され、またワイヤボンディングに より半導体基板15に形成された駆動回路の各パッドが 所定の部位に接続されて完成品とされる。

【0033】(1-2)第1の実施の形態の動作 以上の構成において、プリンタヘッド11では(図2及 び図3)、固定電極17と可動電極21との間に所定の 電圧を印加すると、固定電極17と可動電極21との間 に発生する静電力により可動電極21が固定電極17に 引き寄せられる(図3(A)及び(B))。これにより インク液室13の体積が増大し、図示しないインク流路 よりインク液室13にインクが流れ込む。続いてプリン タヘッド11では、この可動電極21と固定電極17と の間の電圧の印加が中止され、これにより可動電極21 と固定電極17との間の静電力が消滅し、振動板22、 可動電極21の復元力によりインク液室13の体積が元 の体積に戻る。これによりプリンタヘッド11では、イ ンク液室13の圧力が増大し、この圧力の増大によりノ ズル12からインク液滴が飛び出す(図3(C))。こ れらによりプリンタヘッド11では、所定の空隙を間に 挟んで対向するように配置された固定電極 17と可動電 極21とにより静電アクチュエータが構成され、この静 電アクチュエータの駆動によりノズル12からインク液 滴を飛び出させる。

【0034】このようにして動作するプリンタヘッド1 1においては(図1及び図4)、半導体基板15に絶縁 膜16を配置した後、固定電極17が作成され、その 後、絶縁膜18、犠牲層19、可動電極21、振動板2 2が順次作成される。さらに犠牲層19が除去され、こ れにより固定電極17及び可動電極21間に、可動電極 21の動作に必要な空隙23が作成される。これにより プリンタヘッド11においては、半導体製造工程を利用 して静電アクチュエータを作成することができる。従っ てプリンタヘッド11においては、固定電極、振動板等 の構成部材を半導体製造工程による位置決め精度により 作成することができ、簡易かつ確実に静電アクチュエー タを作成することができる。また半導体基板 1 5 上に作 成できることにより、事前に半導体基板 15に駆動回路 14を作成しておくことができ、これによっても製造工 程を簡略化することができる。因みに、このような駆動 回路を別体に作成する場合は、各インク液室の固定電 極、可動電極をそれぞれこのような駆動回路に接続する ことが必要となり、製造に要する時間が極めて長くな る。またこの実施の形態のように、事前に半導体基板1 5に駆動回路14を構成した後、静電アクチュエータを 作成するようにすれば、駆動回路14の製造プロセスに 不純物による汚染等の影響を何ら与えることなく、簡易 50 な製造プロセスにより静電アクチュエータを作成するこ とができる。

Я

【0035】また特に、半導体製造工程を利用して犠牲 層19を作成した後、この犠牲層19を除去して可動電 極21及び固定電極17間の空隙23を作成することに より、この空隙23の厚さを高い精度により所望の厚さ に設定することができる。これにより静電アクチュエー タにおいては、駆動力のばらつきを少なくすることがで き、プリンタヘッド11としては、その分、インク液量 10 のばらつきを少なくすることができる。

【0036】また振動板22も成膜により作成できるこ とにより精度良く膜厚を制御することができ、これによ ってもばらつきを少なくすることができる。

【0037】プリンタヘッド11は、このようにして静 電アクチュエータが作成されると、続いて同様の半導体 製造プロセスを利用した処理により、犠牲層31、被覆 層32が作成され、この被覆層32がノズル形状により 露光される(図5)。さらに犠牲層31を発泡させてイ ンク液室13の厚みが確保されると、被覆層32が硬化 された後、犠牲層31が除去される。

【0038】これによりプリンタヘッド11は、静電ア クチュエータを作成した後においても、半導体製造プロ セスを利用して作成するようになされ、その分、高い精 度によりノズル12等を位置決めすることができる。ま た各種の部材間の液漏れ等も防止することができ、これ らにより簡易かつ確実に作成することができる。

【0039】また犠牲層31を発泡させてインク液室1 3の厚みを確保した後、インク液室の構成部材である被 覆層32を硬化させ、その後発泡した犠牲層31を除去 してインク液室13を作成することにより、犠牲層31 を短い時間により除去して、高い精度によりインク液室 13を作成することができる。

【0040】(1-3)第1の実施の形態の効果 以上の構成によれば、固定電極の上に犠牲層を作成して 可動電極を作成した後、この犠牲層を除去して固定電極 及び可動電極間に空隙を作成することにより、簡易かつ 確実に作成することができ、また駆動回路等を容易に集 積化することができるプリンタヘッドを得ることができ る。

【0041】またインク液室の空間、インク液室にイン クを導くインク流路の空間等の型を犠牲層により作成し た後、この型を含んで覆うように、インク液室、インク 流路の壁材等である被覆層を作成し、その後、犠牲層に よる型を除去することにより、静電アクチュエータの駆 動対象であるインク液室等についても、半導体製造プロ セスを利用して作成することができ、これによっても簡 易かつ確実にプリンタヘッドを作成することができる。 【0042】特に、基板がシリコン基板であることによ り、半導体製造プロセスを簡易に適用することができ、 また駆動回路等を容易に集積化することができる。

【0043】すなわちこの基板に、固定電極及び可動電極間に電圧を印加する駆動回路を事前に作成しておくことにより、簡易に、これらの駆動回路を一体化することができる。

9

【0044】(2)他の実施の形態

なお上述の実施の形態においては、シリコン基板である 半導体基板上にプリンタヘッドを構成する場合につい代え 述べたが、本発明はこれに限らず、シリコン基板に代え てガラス基板を使用する場合等、種々の材質による基板 を必要に応じて広く適用することができる。なおガラス 基板を使用する場合においては、TFTトランジスタに より駆動回路を作成して、駆動回路を一体化することが できる。またガラス基板を使用する場合においては、矩 形形状によるガラス基板を使用する場合においては を形形状によるガラス基板を使用する場合においては できることにより、ラインヘッドに分離することが できることにより、ラインヘッド等の長さの ラインへッドの作成に適用して、無駄を少なくして一枚の 板を使用する場合に比して、無駄を少なくして一枚の基 板より多数のプリンタヘッドを作成することができる。

【0045】また上述の実施の形態においては、インク 液室等についても半導体製造プロセスを利用して作成す る場合について述べたが、本発明はこれに限らず、必要 に応じてインク液室等については、インク液室、インク 流路の形状により加工した樹脂材料を接着して保持するようにしてもよい。

【0046】また上述の実施の形態においては、駆動回路を一体化する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、駆動回路を別体に構成するようにしてもよい。

【0047】また上述の実施の形態においては、本発明*

*をプリンタヘッドに適用するする場合について述べたが、本発明はこれに限らず、プリンタヘッド以外の種々の部品、装置に使用される静電アクチュエータに広く適用することができる。

[0048]

【発明の効果】上述のように本発明によれば、固定電極の上に犠牲層を作成して可動電極を作成した後、この犠牲層を除去して固定電極及び可動電極間に空隙を作成することにより、簡易かつ確実に作成することができ、また駆動回路等を容易に集積化することができるプリンタヘッドの製造方法と、このようなプリンタヘッドに適用可能な静電アクチュエータの作成方法を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施の形態に係るプリンタヘッドについて、静電アクチュエータの作成手順を示す断面図である。

【図2】本発明の第1の実施の形態に係るプリンタヘッドを示す断面図である。

【図3】図2のプリンタヘッドをA-A線により切り取って示す断面図である。

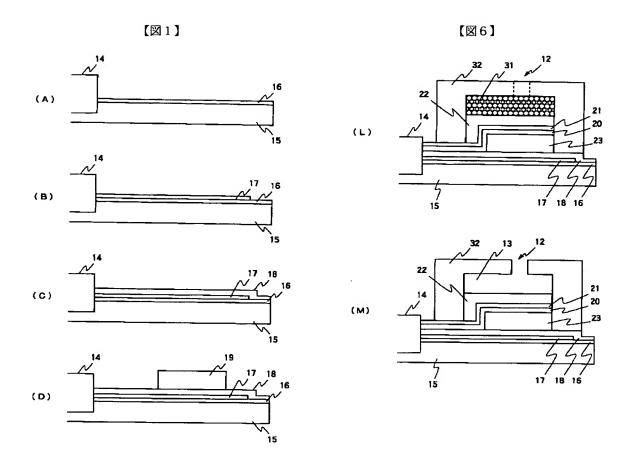
【図4】図1の続きを示す断面図である。

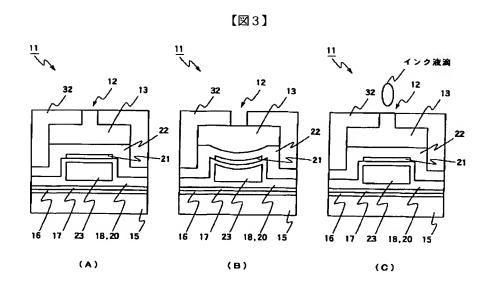
【図5】図4の続きを示す断面図である。

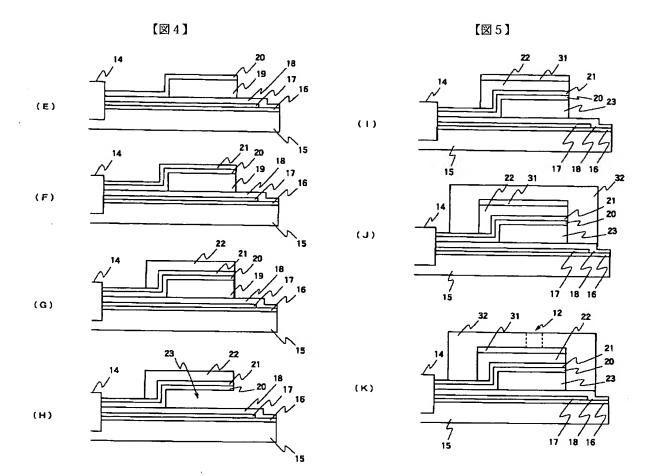
【図6】図5の続きを示す断面図である。

【図7】従来のプリンタヘッドを示す断面図である。 【符号の説明】

1、11……プリンタヘッド、2、15……基板、3、17、21……電極、4、13……インク液室、6、22……振動板、7、12……ノズル、14……駆動回路









(12) United States Patent

Tanikawa et al.

(54) METHOD OF MANUFACTURING PRINTER HEAD, AND METHOD OF MANUFACTURING ELECTROSTATIC ACTUATOR

- (75) Inventors: Toru Tanikawa, Kanagawa (JP); Iwao Ushinohama, Kanagawa (JP)
- (73) Assignee: Sony Corporation, Tokyo (JP)
- (*) Notice: Subject to any disclaimer, the term of this patent is extended or adjusted under 35 U.S.C. 154(b) by 250 days.
- 10/467,975 (21) Appl. No.:
- (22) PCT Filed:

Feb. 14, 2002

(86) PCT No.:

PCT/JP02/01230

§ 371 (c)(1),

(2), (4) Date: Jan. 29, 2004

(87) PCT Pub. No.: WO02/064373

PCT Pub. Date: Aug. 22, 2002

(65)**Prior Publication Data**

> Jun. 17, 2004 US 2004/0115844 A1

(30)Foreign Application Priority Data

(JP) 2001-039713 Feb. 16, 2001

(51) Int. Cl.

B41J 2/16

(2006.01)

U.S. CL 347/71; 216/27; 29/890.1;

(10) Patent No.:

US 7,185,972 B2

(45) Date of Patent:

Mar. 6, 2007

(58) Field of Classification Search 347/54, 68, 69, 71 See application file for complete search history.

(56)References Cited

U.S. PATENT DOCUMENTS

| 5,984,447 A | 11/1999 | Ohashi |
|----------------|---------|----------------------|
| 6,357,865 BI | 3/2002 | Kubby et al 347/68 |
| 6,367,915 B1 | 4/2002 | Gooray et al 347/54 |
| 6.662,448 B2 1 | 12/2003 | Kubby et al 29/890.1 |

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

| JР | • 07-214769 | • | 8/1995 |
|----|-------------|---|---------|
| JР | 08-300650 | | 11/1999 |
| JР | 11-314363 | | 11/1999 |
| JP | 2002-240274 | * | 8/2002 |
| JР | 2003-276194 | * | 9/2003 |

OTHER PUBLICATIONS

English translation of JP 11-314363.*

* cited by examiner

Primary Examiner—Huan Tran (74) Attorney, Agent, or Firm-Sonnenschein Nath & Rosenthal LLP

ABSTRACT

After a movable electrode is formed on a sacrificial laver on a fixed electrode, the sacrificial layer is removed to form a space between the fixed electrode and the movable electrode. Thus, simple and accurate manufacture as well as simple integration of, for example, a driving circuit can be achieved.

2 Claims, 7 Drawing Sheets

